

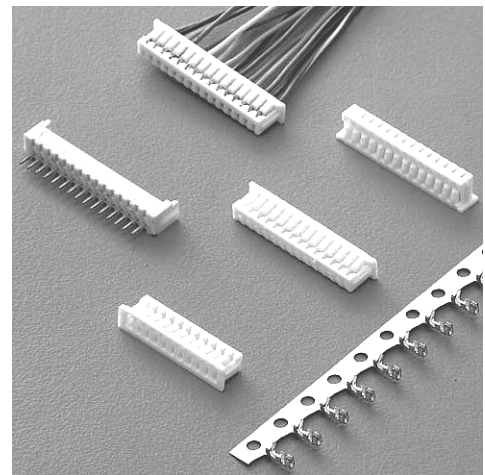
# 560

## Stift- / Buchsenleisten - Crimp-Rast-System - RM 1,25 mm

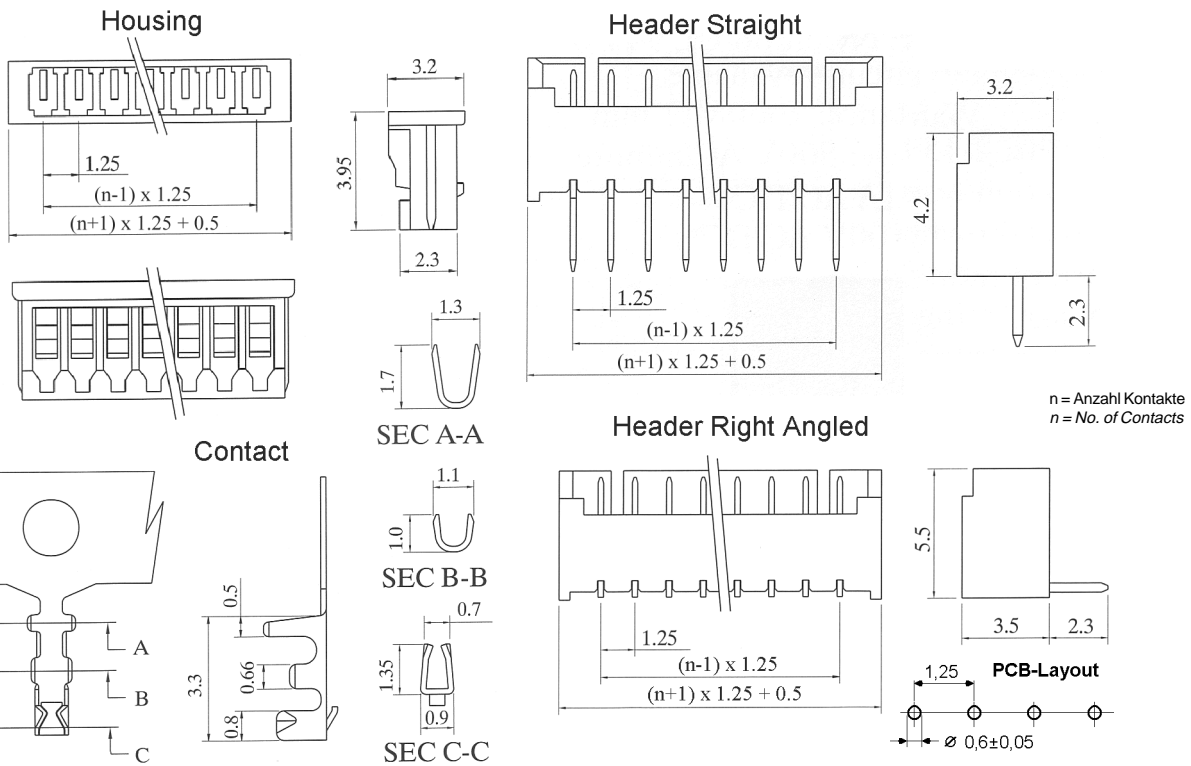
### Friction Lock Header and Crimp Housing - Pitch 1,25 mm

#### Technische Daten / Technical Data:

Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94V0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94V0
Kontaktmaterial	Messing, verzinkt
Contact Material	Brass, tin plated
Kabeldurchmesser	AWG 28-32
Applicable wire	AWG 28-32
Lötbarkeit	IEC512-12A
Solderability	IEC512-12A
Durchgangswiderstand	≤ 20 mOhm
Contact Resistance	≤ 20 mOhm
Isolationswiderstand	> 5x10 <sup>8</sup> Ohm
Insulation Resistance	> 5x10 <sup>8</sup> Ohm
Spannungsfestigkeit	500 V <sub>AC</sub>
Test Voltage	500 V <sub>AC</sub>
Nennspannung	100 V <sub>AC/DC</sub> max.
Current Voltage	100 V <sub>AC/DC</sub> max.
Nennstrom	1 A
Current Rating	1 A
Temperaturbereich	-25°C...+85°C
Temperature Range	-25°C...+85°C
Verarbeitung	Wellen-Lötverfahren; weitere Informationen in Kapitel T
Processing	Wave-Soldering, further informations in chapter T



© W+P PRODUCTS



K

Series	Contacts*	Type*	Plating
560	10 02-15-pol.	3 1 = Buchsengehäuse Housing 2 = Buchsenkontakte Crimp-Contacts 3 = Stiftleiste gerade Pin Header Straight 4 = Stiftleiste gewinkelt Pin Header Right Angled	50 50 = verzinkt tin plated  keine Angabe bei Gehäusen Not Necessary for Housings

(\* Bestellbeispiel - Bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* Order example - To be replaced by your specifications.)

TEL.: +49 5223 98507-0  
FAX : +49 5223 98507-50

**W+P PRODUCTS**

E-MAIL: sales@wpro.com  
INTERNET: www.wpro.com

K4

## Wellen-Lötverfahren Wave-Soldering

Bauteile sollten bei 260°C für max. 5 Sekunden verarbeitet werden.  
*Items should be soldered at 260°C for max. 5 seconds.*

Empfohlenes Wellen-Lötprofil:  
*Recommended Wave-Soldering profile:*

